

日時 2012年1月18日(水)~20日(金)  
場所 東京ビッグサイト 西L3-7



**共晶ボンダー**  
【実機展示】

新製品

発光素子をモジュールへ組立てる装置

- ・Au-Sn共晶接合の採用、高輝度・高出力LEDに最適
- ・高精度アライメント ( $\pm 15\mu\text{m}$   $3\sigma$ )
- ・高速性と高歩留りを両立、ボイドの低減化を実現
- ・多様なプロセスへの対応を想定したチップとステージの個別加熱方式を採用



**ブレーキング装置**  
【実機展示】

新製品

各種デバイス・基板を劈開分断する装置

- ・画像処理による作業の自動化
- ・省スペース設計
- ・押し割り式/衝撃式対応
- ・加重検出/ウェーハ反り矯正/割検知機能など、豊富なオプション



**片面ラッピングマシン**

薄板化プロセス対応

ウェーハの片面をラッピングする装置

- ・高精度フェーシング装置により定盤精度を10um以下維持、容易に修正可能 (オプションで溝入れ加工も可能)
- ・トップリング強制駆動、トップリング揺動機能
- ・トップリング中押し機構(OP)により、セラミックプレート内のウェーハの形状調節可能
- ・コンディショニング専用ステーションを設け、インプロセスでの調整可能



**ウェーハ面取機**

薄板化プロセス対応

$\phi 2'' \sim 8''$ までの各種ウェーハの面取りを行う装置

- ・従来機の面積比 1/2 W1,200 x D1,300
- ・生産性向上(最速22sec/wf)
- ・メンテナンス性向上
- ・OF直線性が従来の2/3(保証値10um)



**ウェーハデマウンター**

薄板化プロセス対応

接着された支持基板からウェーハを剥離し、洗浄・マウントする装置

- ・剥離・洗浄プロセスを自動・半自動で行う
- ・極薄ウェーハ( $< 50\mu\text{m}$ )をダメージなく処理可能
- ・BG面へのWAX回り込みなし



**精密ディスペンサー**

生産性の高い安価な高精度ディスペンサー装置

- ・LED用Si系熱硬化性樹脂を高速に精度よく塗布
- ・スクリーンとJetの2ヘッド
- ・ドット・線引・描画など様々な塗布形状に対応
- ・金属イオン発生一切なし

ダイトエレクトロン株式会社

東京機械営業部	〒102-8730	東京都千代田区麹町3-6(住友不動産麹町ビル3号館)	TEL(03)3264-0211
大阪機械営業所	〒532-0003	大阪市淀川区宮原4-6-11	TEL(06)6399-6578
名古屋機械営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3-10-22(東朋ビル)	TEL(052)249-3005
福岡機械営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3-1-26(ゼンリン福岡ビル)	TEL(092)475-1521
仙台営業所	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央3-6-22(駅前のおぞみビル)	TEL(022)711-0321

LEDに関する前工程・後工程・検査工程において  
取扱製品群を下記アドレスにて掲載しております。  
[http://www.daitron.co.jp/led/index\\_led.htm](http://www.daitron.co.jp/led/index_led.htm)

